令和６年５月28日
庁舎整備担当部

本庁舎等整備工事の設計変更について

1. 主旨

世田谷区本庁舎等整備工事は、現在、第一庁舎及び第三庁舎の解体工事に本格的に着手し、区民交流施設やレストラン整備を含む２期棟の令和８年９月の完成に向けて、工事を進めている。

安全第一かつ良質な新庁舎整備に向けて、現時点で、区が必要と判断した設計変更概要及び変更に係る概算金額等について報告する。

2．変更内容の概要
第一庁舎北側の既存樹木（けやき）の伐採

①変更理由

当該樹木は、現位置で保存することとしていたが、２期工事で新設する地下工作物と近接しており、令和４年11月、根の形状等を確認するため、試掘調査を実施。

調査の結果、新設する地下工作物と当該樹木の根部分が干渉し、一部、根の伐採が必要であることが判明。

更に、令和４年12月、当該樹木の幹部分に断層撮影(CT)調査を実施したところ、空洞率が約46%であり、根の一部を伐根した場合、倒木の恐れが高い。

<u>当該樹木を伐採し、けやきを新植する。</u>

当該樹木の写真

②変更金額（税込概算）

約400万円

③本変更に伴う主なスケジュール

令和６年６月下旬　当該樹木の伐採
令和８年８月　けやき新植